
7.6 本章習題

1. 試述選擇基材的考慮因素，並描述不同基材的特性與應用。
2. 試述元件隔離在基材工程內的分類如何，並描述如何改善元件隔離。
3. 試述 STI 在製程遭遇的問題及如何改善。
4. 試述通道工程中，SSR 與 uniform well 的特性比較。
5. 試述影響臨界電壓的因素有哪些。
6. 試述埋入通道與表面通道的特性。
7. 試述源／汲極的工程需求有哪些。
8. 試述如何改善短通道現象及如何形成淺接面。
9. 試述製程微縮後對電路造成的影響，以及製程的開發方向為何。
10. 試述低介電材料在半導體製程中應具備的條件。